

# 《电子机械工程》专题征稿通知

## “电子装备轻量化设计与制造”专题

信息化和智能化是新一代航空、航天、车辆、船舶等高技术装备的关键特征,作为核心功能器件的系列电子装备,其日益攀升的性能和功能要求使系统复杂度和装备重量、体积不断提升,导致能耗增加、散热困难,极大影响了装备服役性能。

为应对这些挑战,未来电子装备的轻量化显得尤其重要。通过发展轻量化材料、结构、系统的设计与制造技术,有效地减小电子装备重量和体积,提高性能、能效和可靠性,对提升我国高技术装备性能、实现电子装备设计制造技术向高端发展具有重要意义。

### 征稿方向(包括但不限于):

1. 电子装备结构轻量化设计技术
2. 材料结构工艺功能一体化设计技术
3. 电子装备高性能制造技术
4. 电子装备多物理场仿真与设计技术
5. 电子装备智能材料与结构技术
6. 面向增材制造的电子装备结构与工艺技术

### 专题主编:

朱继宏	教授	西北工业大学
王从思	教授	西安电子科技大学
马小飞	研究员	西安空间无线电技术研究所
张慧玲	研究员	中国电子科技集团公司第二十研究所

### 征文要求:

1. 征文论点明确、论述严谨、论据充分、图标清晰工整、尚未公开发表;
2. 来稿必须由作者单位进行保密审查,需在投稿时向编辑部提交保密审查表(盖章原件);
3. 稿件字数应不少于 5000 字,采用 Word 排版;
4. 稿件需包含题目、作者姓名及单位、摘要、关键词(通栏排,提供中英文);引言、正文、结束语、参考文献、作者简介(双栏排),通信地址及联系方式附文末。

### 征稿日期:

截稿日期: 2024 年 4 月 30 日

出版日期: 2024 年第 3 期

### 投稿方式:

投稿请在《电子机械工程》网站(<http://dzjxgc.ijournals.cn>)“作者登录”处注册、上传,备注处注明:“电子装备轻量化设计与制造”专题投稿。

### 联系方式:

地 址: 南京市雨花台区国睿路 8 号《电子机械工程》编辑部

邮 编: 210039

联系人: 汪老师 025-51821082

E-mail: dzjxgc@126.com